



LOTPASTE SC BLF03

Typ ISO 1.2.3.C

Die SC BLF03 ist ein konsequent weiterentwickeltes High-Tech-Produkt, das für alle sogenannten **bleifreien** SMT-Anwendungen bestens geeignet ist. Ihrer Entwicklung liegen nicht nur langjährige Erfahrungen auf dem SMT-Gebiet, sondern auch die sorgfältige und strenge Beachtung der Richtlinien von ISO-, EN-, IPC-, und MIL-Normen zugrunde.

Die SC BLF03 ist physikalisch gesehen eine gleichmäßige Mischung aus einem **bleifreien** Weichlotpulver, in allen erforderlichen Legierungen und Körnungen lieferbar, mit einem organischen Bindemittel auf **Kunsthartzbasis**, das der RE L0 nach J-STD 004 (F-SW32) entspricht (übertrifft die RMA-Anforderungen!). Dadurch gehört sie zu den allerbesten "no-clean"-Pastentypen. Außer der hervorragenden Konturenstabilität, keiner Lotkugel- oder Spritzerbildung, einer enorm langzeitigen Verarbeitbarkeit und langen Lagerzeit, sowie hoher Temperaturstabilität, zeichnen diese Paste folgende Vorteile aus:

- *SC BLF03* Klarer, geringer (4,5%) Rückstand, begünstigt den "in circuit"-Test !
- *SC BLF03* Eine wahre "no clean"-Paste
- *SC BLF03* Enthält Korrosionsinhibitoren
- *SC BLF03* Eine hervorragende Druckqualität, stundenlang !
- *SC BLF03* Eine enorm hohe Klebekraft
- *SC BLF03* Für "fine und super fine pitch" Anwendungen die beste Wahl
- *SC BLF03* Einwandfreie Lötergebnisse mit allen gängigen Lötprofilen

PHYSIKALISCHE DATEN

Metalllegierungen

<u>Bevorzugte Legierungen</u>	Schmelzpunkt	Gemäß Internationalem Standard liefern wir diese Legierungen in den Klassen:
Sn96,5/Ag3,5	221°C	Kl.3 (T3) 25 – 45 µm Kl.4 (T4) 20 – 35 µm Kl.5 (T5) 10 – 25 µm
Sn95,5/Ag3,8/Cu0,7	217 – 219°C	
Sn96,5/Ag3/Cu0,5	217°C	
Sn99,3/Cu0,7	227°C	

Allgemeine Physikalische Daten

<u>Viskosität:</u> *		Konturenstabilität – DIN 32513		Solderballing nach IPC	Benetzung nach IPC
		Sofort	20min 80°C		
750 Pas	Pulverklasse III	Kl.1 = 0,2	0,2	1	1
900 Pas	Pulverklasse IV	Kl.2 = 0,2	0,3		

*Die Angaben beziehen sich auf die Messung mit dem Brookfield RVT-DV-II Viskosemeter, Spindel TF 5R/pm, bei 25°C mit dem Heliopath-System (+/- 10%). Paste = 90% Metallgehalt.

OBERFLÄCHENWIDERSTAND (SIR) und elektrolytische Korrosionswirkung nach IPC 650

Messungen am	4.Tag	<u>21.Tag</u>
	4,4x10 ³	6,8x10 ²

QUALIFIKATIONEN

Die Lotpaste SC BLF03 ist eine RMA-Paste die den Anforderungen der MIL-QQ-S571e entspricht. Der Korrosions-, Lotkugel- und der Benetzungstest sowie die Konturenstabilitätsprüfung (nach SN 59650) wurden bestanden. Laboruntersuchungen bestätigen korrosionsfreie, der RE-L0 (no-clean) entsprechende, Rückstände, die auf der Leiterplatte bedenkenlos verbleiben können, auch unter dem Schutzlack.

LAGERUNG

Ungeöffnetes Gebinde bei ca. 20°C (RT) : 6 Monate. **Eine Lagerung im Kühlschrank ist nicht notwendig!**

Im geöffneten Zustand bzw. am Rakel der Druckeinrichtung ist die max. Verarbeitungszeit, wie auch immer, abhängig von den Umwelteinflüssen denen die Paste ausgesetzt wird.

VERBRAUCHERHINWEISE

Nach Entnahme der Paste, das Gebinde möglichst dicht verschließen. Die benutzte Paste soll nicht mit der frischen zusammen aufbewahrt werden. Im laufenden Arbeitsprozess darf selbstverständlich neue Paste der älteren zur Auffrischung zugeführt werden. Verschiedene Lotlegierungen und Pastentypen sollte man nicht vermischen.

Empfohlene Rakelgeschwindigkeit: 15-100mm/s.

Merke! Der Pastendrucker ist immer schneller als der schnellste Bestücker in Ihrer Linie. Das Wichtigste ist, daß die Paste beim Drucken am Rakel abrollt.

Für Schablonendruck wird eine Paste mit 90% Metallgehalt empfohlen

Die Reinigung der Schablone kann mit einer Alkoholmischung erfolgen, aber das Reinigungsmedium darf unter keinen Umständen mit der Paste in Verbindung kommen. Aus diesem Grund empfehlen wir den **SC Schablonenreiniger**.

Die Lotpaste ist in allen gängigen Reflow-Systemen mit exzellenten Lötgergebnissen zu gebrauchen.

So bestellen Sie Ihre Solder Chemistry Paste

Legende	Pastentyp	Korngröße	Legierung	Flußmittelanteil	Gebindegröße
z.B.	SC BLF03	T3	96,5/3,0Ag/0,5Cu	11%	500g
	SC BLF03	T4	96,5/3,5Ag	11%	200g

Bestellbeispiel nach DIN:

Lotpaste(SC...) L-Sn96,5Ag3,5 / 1.2.3.C / 89-3 200g(Gebinde)

Solder Chemistry ; Fragnerstraße 4 ; D-84034 Landshut
Tel. ++49/871/4309500 ; Fax. ++49/871/43095020
e-Mail: info@SolderChemistry.com ; www.solderchemistry.com

Vorstehende Angaben sollen sie bestmöglich informieren. Eine Verbindlichkeit kann jedoch aufgrund der Vielseitigkeit der Materialien, Anwendungen und Arbeitsprozesse, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte und Verpflichtungen Dritter, nicht übernommen werden.